

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

广州方邦电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>券商策略交流会</u>
参与单位名称及参与人姓名	盘京资本、华商基金、博时基金、复胜资产、天风证券、东北证券
时间	2026年5月
地点	深圳福田香格里拉酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王作凯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2026年一季度报告已披露，请介绍业绩、业务相关情况</p> <p>2026年一季度实现营收7792.77万元、归属于上市公司股东的净利润-1731.28万元，与上年同期相比均有所下降，主要系上年同期受托开发可剥铜项目一次性确认了收入、利润，同时本报告期内股权激励费用有所增加，并计提了相关存货跌价减值。</p> <p>如剔除上年同期的受托技术开发项目一次性确认收入的影响，2026年一季度营业收入实际同比增长17.58%，受益于薄膜电阻、FCCL、可剥铜等新产品的销售收入同比均有所增长。</p>

二、在人工智能（AI）技术的快速发展下，当前可剥铜有哪些新机遇、新增量？公司可剥铜客户验证及市场开拓的进展情况如何？

我们认为，AI 技术快速发展预计将带动可剥铜市场需求持续增长：（1）光模块向 800G-1.6T-3.2T 迭代，需要使用类载板（SLP）承接，SLP 使用 mSAP 工艺制备，标配使用可剥铜，因此光模块的快速迭代增大了对可剥铜的需求。（2）高端存储芯片目前紧缺，三星、海力士、美光等海外巨头以及国内的长鑫、长江等头部企业都在扩产，存储芯片的封装本来就是可剥铜的主要市场需求来源，当前存储芯片的扩产也增大了对可剥铜的需求。（3）英伟达等相关头部企业提出的 CoWoP（Chip on Wafer on PCB）技术路线，有望在 2027 年落地，该路线场景下，传统封装基板被取消，芯片通过硅中介层直接与高精度 PCB 主板连接，倒逼主板线路细化、类载板化，可剥铜作为 PCB 线路细化的关键材料，CoWoP 技术路径有望提升可剥铜的市场容量。

与此同时，可剥铜产能供应逐渐趋紧，据相关资料显示，日本三井金属公司占据了可剥铜超 90% 的市场，三井当前产能约 500 万平方米/月，预计到 2028 年提升至 580 万平方米/月左右，扩产幅度不大，可能进一步加剧可剥铜市场的紧张情况。

总而言之，可剥铜下游需求保持增长，上游供给相对偏紧的市场格局，有望推动下游客户加快对国产产品的验证导入。当前，公司可剥铜陆续通过相关客户及终端的测试认证，持续获得小批量订单，后续将根据客户及终端应用反馈，持续提升产品品质和良率，并结合相关项目排产节奏，推动订单上量工作。鉴于公司可剥铜业务目前收入占比较小，后续市场开拓及订单放量情况仍存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

三、关于 FCCL 产品的进展及核心竞争力

公司大力推进挠性覆铜板（FCCL）业务，“原材料自研自产”战略逐步深入，目前，使用自产铜箔生产的 FCCL 产品已实现规模销售，预计 2026 年全年销售收入将持续增长，成为公司新的业绩增长极。同时，公司使用自产铜箔+自产 PI/TPI 为原材料生产的 FCCL 产品也在持续送样认证中，可进一步提升 FCCL 业务盈利能力，有望从今年下半年起逐步获取订单。

FCCL 行业市场竞争充分，依托于对超薄高频铜箔技术、PT/TPI 配方技术的良好布局，公司可实现 FCCL 产品原材料的自研自产，一方面可逐步摆脱对上游供应商的依赖，另一方面可较好降低生产成本、提升产品竞争力。公司在 FCCL 业务的规划是对标日本 Nippon Steel、韩国 NexFlex 等高成长、高盈利能力企业，坚定发展成为国内头部、全球前十的 FCCL 研发生产商。

四、关于薄膜电阻、热敏型薄膜电阻产品的进展及未来规划

公司薄膜电阻产品主要应用于电子产品声学模块，当前已通过部分客户验证，持续获得批量订单，后续订单进一步起量趋势良好。薄膜电阻亦称埋阻铜箔，将电阻埋入线路板内部线路，取消了传统焊点，可较大幅度提升信号完整性和模块功能稳定性，可应用于低轨卫星等航空航天场景，根据相关客户反馈，公司薄膜电阻已批量应用于卫星通讯领域。

热敏型薄膜电阻可随温度的变化而呈现阻值变化，适用于电子产品内部的芯片主动热管理。随着新能源汽车、AI 技术的高速发展，芯片制程愈加先进，运算速度愈加高速化，由此带来了愈加广泛而严重的芯片发热、散热问题。热敏型薄膜电阻植入于芯片组件与主板连接部分，可及时、精确地感知温度细微变化，进而通过软硬件的设计来实现芯片的主动热管理。

	<p>热管理是新一代电子产品必须解决的普遍而迫切问题，目前该产品正处于相关客户的测试流程中。</p> <p style="text-align: center;">五、关于公司对未来的展望</p> <p>在 AI 技术快速发展的时代环境下，对算力、运算速度的极致追求，推动芯片封装及电路板细线化、芯片主动热管理等技术趋势越来越明确，催生 PCB 产业链开启新一轮创新周期。</p> <p>经过近几年的布局和辛勤耕耘，公司 FCCL、可剥铜、薄膜电阻（含热敏型）等新产品作为芯片封装及电路板细线化、芯片主动热管理的关键材料，陆续取得良好进展，逐步突破“从 0 到 1”的最艰难阶段，叠加在电磁屏蔽膜领域，公司出货量已稳居全球前列，并积极拓展新应用方向和新客户，预计以上因素将推动公司业绩逐步向好。</p> <p style="text-align: center;">以上预测具有不确定性，不构成投资承诺，敬请理性决策、注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	